

电解式膜厚计 GCT-311

走在时代尖端的新技术

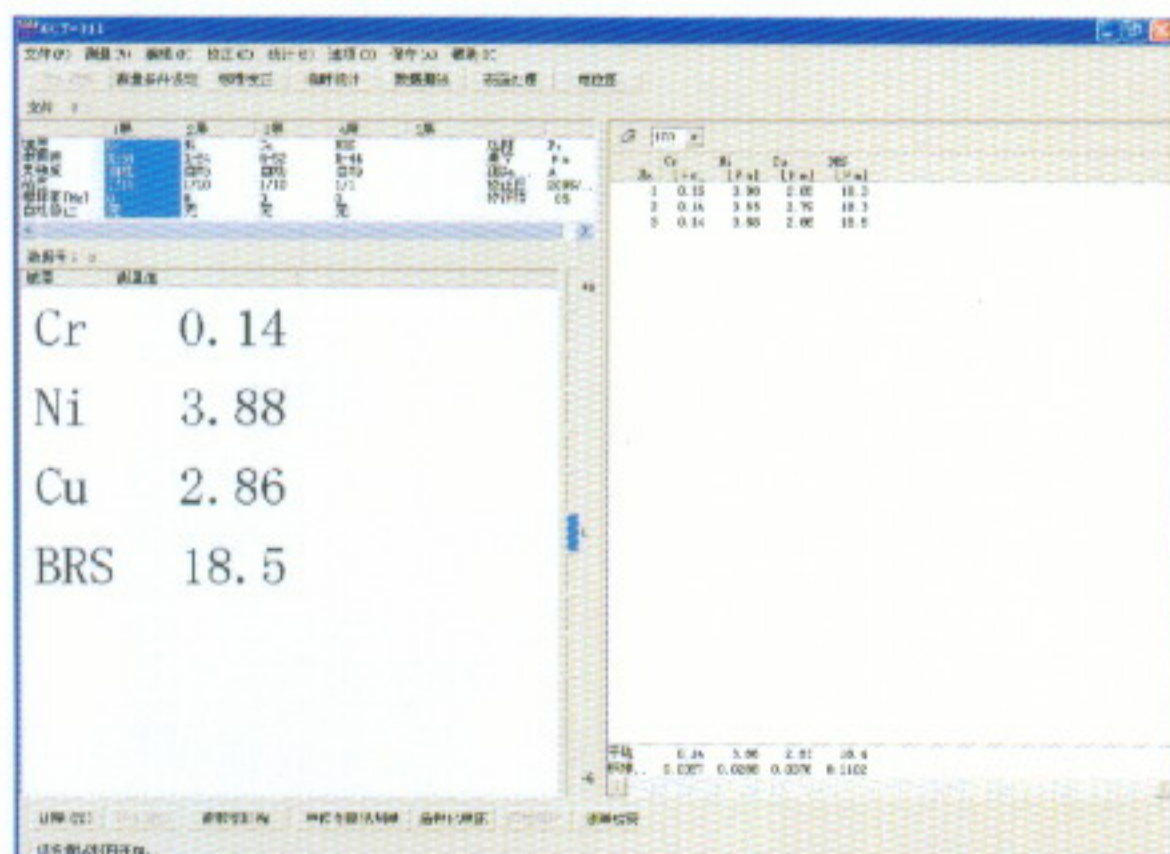


适合各种镀层的高精度膜厚计

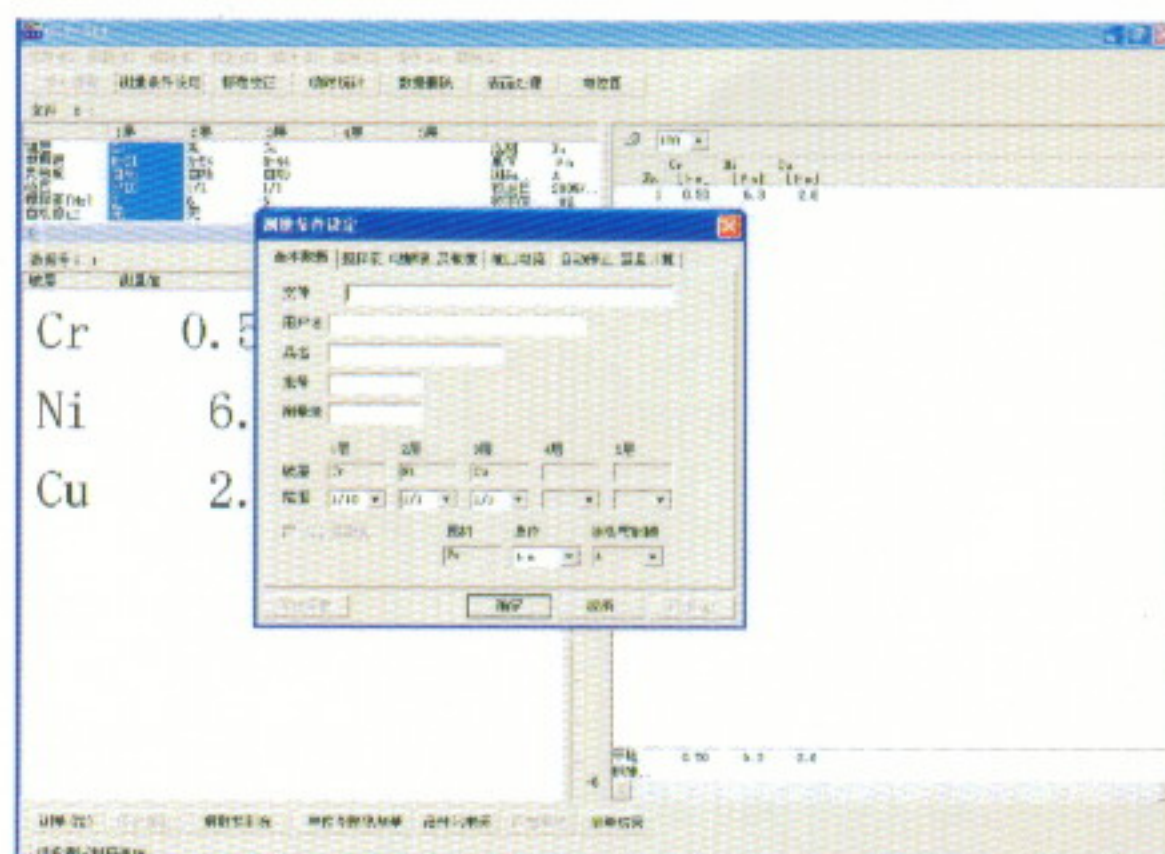
|| GCT-311 的特长:

- 1** 使用计算机来操控，提升操作的方便性，机能也更多元化
- 2** WINDOWS兼容规格，数据处理也非常容易
- 3** 可藉由上下限设定，当有异常值发生时，测量值将会以红色字表示，并有警告声告知
- 4** 打印机所使用的印表纸及热感纸，可依自己的用途来选择
- 5** 可以了解测量部品的表面处理方法
- 6** 可以最多登录至50个测量频道
- 7** 可以设定最多5层的测量条件
- 8** 使用比较电极及电位图测量，针对二层镍及三层镍的电位差测量，非常容易的
- 9** 测量「锡/铜」层时，对纯锡层及合金层可以个别来测量
- 10** 由镀层及底材的组合，会自动显示适用的电解液的种类

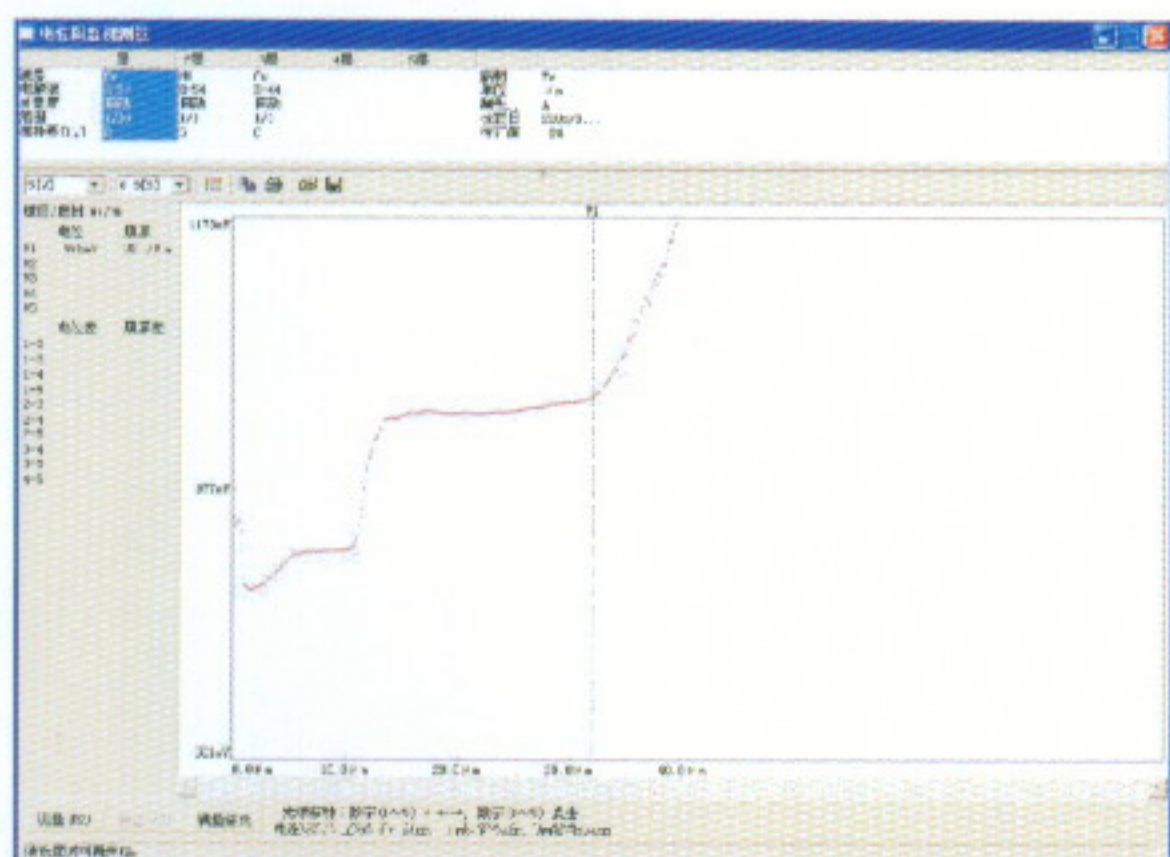
画面表示



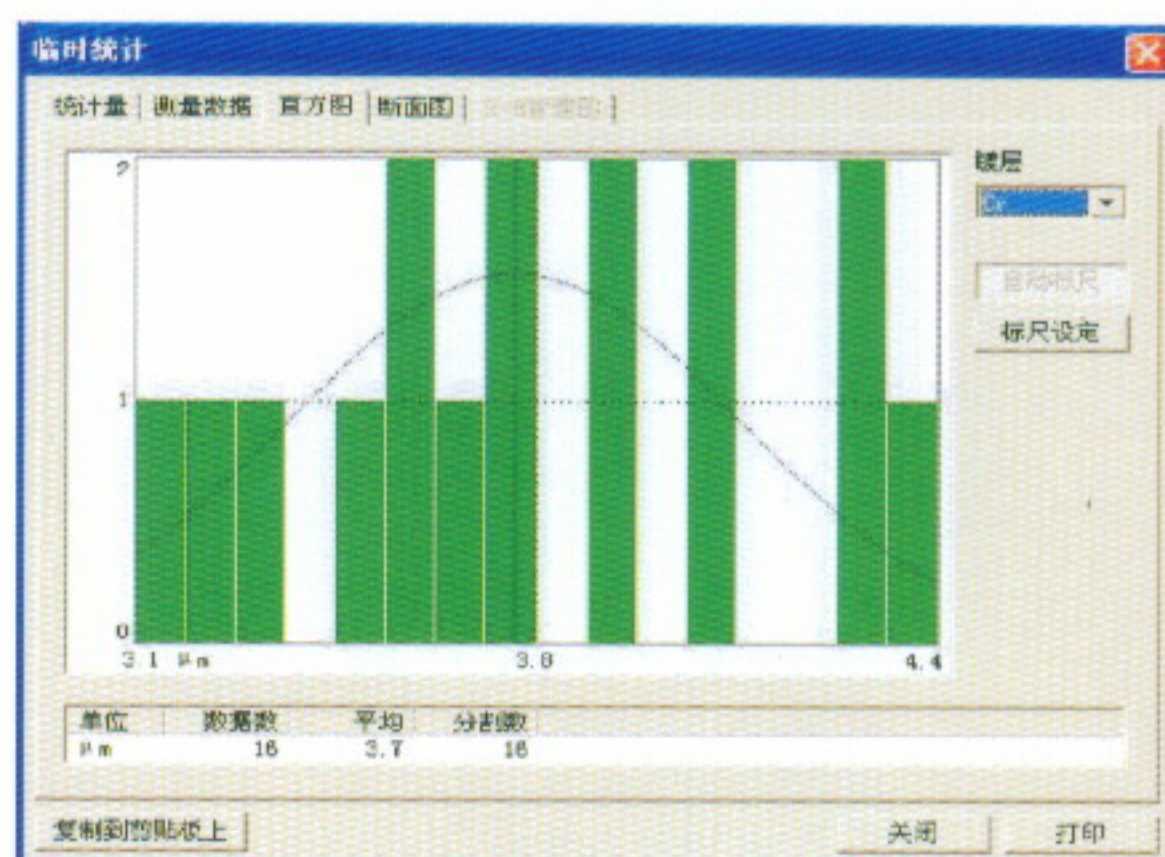
测定画面



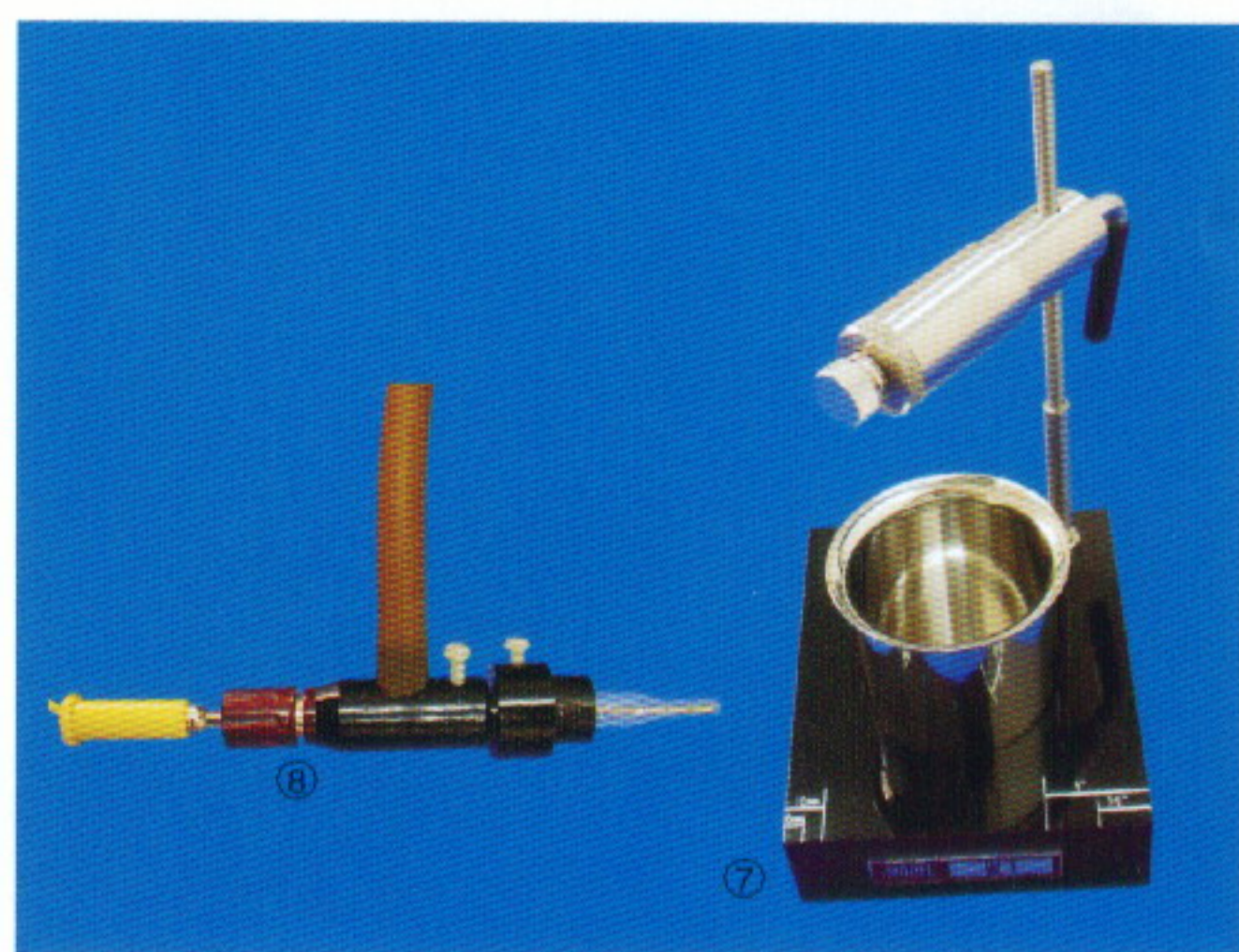
测定条件设定画面



电位测定画面



附属品



■ 测量台: 设定位置非常简单, 圆柱形也是一次设置即OK! 特别是同一形状连续测量是最为适合。

标准附属品: ① 电解液(100ml) 1瓶、② 洗净瓶1个、废液瓶1个、③ 测量台、④ 橡皮测头A, B, C、⑤ 电解槽A, B、⑥ 标准片1片、清洁液(100ml)1瓶、塑料杯、吸管、搅拌玻璃管、保险丝、中文操作说明书。

■ W
(选

T: 线材及宽度在1.7mm以下的微小部件的测量, 使用WT是有必要的
购): ⑦ WT(Wire Tester)、⑧ 比较银电极

各种底材及镀层的组合及电解试液

镀层种类	电解液	底 材	镀层种类	电解液	底 材
铜	K-44	铁、铝、镍、铁镍合金、不锈钢、银、铁镍钴合金、钼、非金属	金	K-56	青铜、铜、镍、化学镍、锌白铜、钴
铜	K-52	青铜、铍铜、铅、锌、锌白铜、镉	银	K-44	铁、铝、铁镍合金、铁镍钴合金
镍	K-54	铁、铝、青铜、铬镍铁合金、钼、锰、不锈钢、非金属、铬	银	K-48	青铜、铜、锡、非金属
化学镍	K-57	铁、铝、铁镍合金、非金属、不锈钢、铬镍铁合金	银	K-48G	青铜、镍银合金、锌白铜
铬	K-47	青铜、铜、钴、镍银合金、镉	锡铅合金 (60:40)	K-44	铁、镍、青铜、铜、非金属
铬	K-51	铁、铝、镍、不锈钢、非金属、铬镍铁合金	钴	K-54	铁、青铜、铜、非金属
锌	K-46	铁、铝、青铜、铜、镍、非金属、锡、钼	青铜	K-44	铁、镍、非金属
锡	K-47	铁、镍、镍银合金、锌白铜、铁镍合金、镉、非金属			
锡	K-51	镍	表面处理液	N-64	测量镍层后之附着物去除
锡	K-50	铜、青铜	表面处理液	C.S.	被测定物之清洁及树脂研磨用

规格

测量范围	0.006 ~ 300 μm
最小分辨率	0.001 μm
本体精度	1%
测量单位	μm 、nm、mil、MI
测量面积	1.7 ϕ 、2.4 ϕ 、3.4 ϕ
电 源	AC 220V $\pm$ 10%
本体尺寸	W 265 $\times$ D215 $\times$ H138 mm
重 量	4.5Kg
控 制	微软窗口兼容计算机

※ 敝公司有执行售后服务，为了能正确的测量，建议能每年定期校正一次。如有镀层膜厚的相关问题，欢迎与敝公司讨论。

标准片种类

Chromium/Brass	(铬/青铜)	5 ~ 7 μm
Chromium/Copper	(铬/铜)	5 ~ 7 μm
Chromium/Steel	(铬/铁)	3 ~ 6 μm
Chromium/Nickel	(铬/镍)	0.3 ~ 0.5 μm
Copper/Steel	(铜/铁)	10 ~ 14 μm
Copper/Zinc	(铜/锌)	5 ~ 7 μm
Nickel/Steel	(镍/铁)	10 ~ 14 μm
Nickel/Brass	(镍/青铜)	10 ~ 14 μm
Nickel/Copper	(镍/铜)	10 ~ 14 μm
Silver/Steel	(银/铁)	10 ~ 14 μm
Silver/Brass	(银/青铜)	10 ~ 14 μm
Silver/Copper	(银/铜)	10 ~ 14 μm
Tin/Steel	(锡/铁)	10 ~ 14 μm
Tin/Copper	(锡/铜)	10 ~ 14 μm
Tin/Brass	(锡/青铜)	10 ~ 14 μm
Zinc/Steel	(锌/铁)	10 ~ 14 μm
Zinc/Brass	(锌/青铜)	10 ~ 14 μm
Zinc/Copper	(锌/铜)	10 ~ 14 μm
Gold/Nickel	(金/镍)	0.5 ~ 0.7 μm
Gold/Brass	(金/青铜)	0.5 ~ 0.7 μm
Gold/Copper	(金/铜)	0.5 ~ 0.7 μm

上述表示：左边为镀层，右边为底材
(例) 金/铜为底材为铜上面镀金的意思
上述表示以外的组合及希望厚度可以讨论订作

株式会社 **电 测**
ELEC FINE INSTRUMENTS CO., LTD

代理店
CHTEK 菖 鴻 科 技 有 限 公 司
東 莞 市 永 昌 檢 測 設 備 有 限 公 司

地址：臺北縣五股鄉四維路142巷14弄14號 TEL: (02) 2985 2339 FAX: (02) 2987 2070
地址：東莞市萬江牌樓基工業區興隆街一巷一號 TEL: 0769-22783901/2 FAX: 0769-22783903
<http://www.chungtech.com.tw> www.c-hungtech.com E-mail: yongchangtest@yahoo.com.tw